

訂正版

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004年7月1日 (01.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/056162 A1

(51) 国際特許分類: H05K 3/18, 3/06, 1/18,
3/32, H01L 21/60, H01C 1/14, 13/02

NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW.

(21) 国際出願番号: PCT/JP2002/013203

(22) 国際出願日: 2002年12月18日 (18.12.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許
(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI 特
許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ケイ
テックデバイス株式会社 (K-TECH DEVICES
CORP.) [JP/JP]; 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大
字中箕輪14016番30号 Nagano (JP).

規則4.17に規定する申立て:

— USのための発明者である旨の申立て (規則
4.17(iv))

(72) 発明者; および

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 高山 利治
(TAKAYAMA, Toshiharu) [JP/JP]; 〒399-4601 長野県
上伊那郡箕輪町大字中箕輪14016-30 ケイテックデ
バイス株式会社内 Nagano (JP).

(48) この訂正版の公開日:

2005年6月23日

(15) 訂正情報:

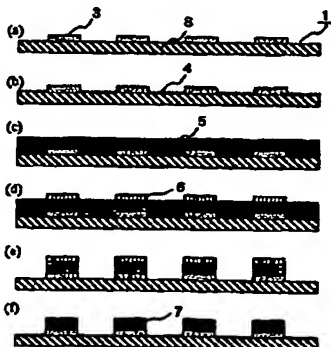
PCTガゼット セクションIIのNo.25/2005 (2005年6月
23日)を参照

(81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: FLIP-CHIP MOUNTING ELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME, CIRCUIT
BOARD AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME, METHOD FOR PRODUCING PACKAGE

(54) 発明の名称: フリップチップ実装用電子部品及びその製造法、回路板及びその製造法、実装体の製造法



(57) Abstract: A method for producing a flip-chip mounting electronic component hav-
ing a plurality of terminals (3) spotted on the mounting face (1) with a conductor being
formed on the terminal (3) in which flip-chip mounting capable of shortening the dis-
tance between bumps (7) is realized. A step for covering the mounting face (1) with a
conductor of specified thickness, a step for masking the conductor surface at such parts as
corresponding to the terminal (3) parts, and a step for removing the conductor except the
mask (6) part are carried out in this order. The bump is preferably composed of copper.

[機業有]

WO 2004/056162 A1